

**国信证券股份有限公司关于
苏州锦艺新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
的上市保荐书**

保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《苏州锦艺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

目 录

保荐机构声明	1
目 录.....	2
一、发行人基本情况	3
二、本次发行的基本情况	21
三、保荐机构项目组人员情况	22
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	23
五、保荐机构承诺	24
六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序	24
七、保荐机构对发行人是否符合创业板上市条件的说明	24
八、保荐机构针对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明	27
九、对发行人持续督导期间的工作安排	30
十、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式	30
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项	30
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论	31

深圳证券交易所：

苏州锦艺新材料科技股份有限公司（以下简称“锦艺新材”、“发行人”、“公司”）拟申请首次公开发行股票并在贵所创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定的首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件，同意向贵所保荐锦艺新材申请首次公开发行股票并在创业板上市。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：苏州锦艺新材料科技股份有限公司

英文名称：Suzhou Ginet New Material Technology Co., Ltd.

注册地址：常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号

股份公司成立日期：2021 年 12 月 1 日

有限公司成立日期：2017 年 2 月 9 日

联系方式：0512-52653039

经营范围：非金属材料、非金属制品及其专用设备的研发、生产、销售及相关售后服务；非金属矿产的开发设计、深加工及销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；电池制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；特种陶瓷制品制造；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主营业务

公司专注于先进无机功能性粉体材料领域创新性技术研发及产业化应用，历经二十余载耕耘，逐步探索出一条从致力于国产替代突破至实现自主技术引领的

发展路径，目前已成长为电子信息领域无机功能性粉体材料行业领先企业，并以电子信息领域为技术原点构建起平台型技术，针对具有技术同源性的多种材料进行拓展性开发，打造电子信息功能材料、导热散热功能材料和其他新兴功能材料三大产品矩阵，实现以电子信息领域为核心，辐射导热散热、锂电新能源、先进涂料、半导体制造与封装等领域的多元业务布局。

公司以高性能球形硅微粉为核心的电子信息功能材料，系高等级高速覆铜板，以及高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）用高端覆铜板的核心填充材料，下游客户已覆盖台光电子、联茂电子、台耀科技、生益科技、南亚新材、华正新材、南亚电子、建滔化工、韩国斗山、日本松下等全球前十大高速覆铜板制造商（CR10>90%），近年来随着 AI 人工智能的迅速发展，被广泛应用于英伟达、亚马逊、谷歌、AMD、Meta、英特尔、浪潮等国际知名科技企业的 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块、低轨卫星等。2023 年至 2025 年期间，根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会证明，在高等级高速覆铜板用球形硅微粉领域，公司全球市场占有率超过 40%，位列第一；根据中国非金属矿工业协会证明，公司在覆铜板用硅微粉领域销售规模位居国内第一。公司系少数同时掌握化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅三种高端粉体制备技术，并较早在覆铜板领域实现规模化应用的企业，根据中国非金属矿工业协会开具的证明，公司化学合成新工艺“避开了国外的技术封锁，极大地提升了我国高端球形硅微粉的加工水平，产品性能指标达到国际领先水平，填补了国内空白”。

公司依托多年来在电子信息领域的技术积累和产业化的理解，逐步构建起可覆盖多维技术体系、多元产品矩阵的平台型技术，并锚定高附加值、创新性应用前景领域进行拓展性开发，逐步实现平台型技术在导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料等领域的多元化应用，并成功进入多个行业龙头客户供应链体系，目前与陶氏化学、汉高等导热散热领域知名企业，恩捷股份、金力股份等锂电池隔膜行业龙头，阿克苏诺贝尔、立邦等涂料代表性企业建立深厚的合作关系。其中，在导热散热功能材料领域，氮化铝、氮化硼等高端导热粉体材料曾长期被海外厂商占据主导地位，公司依托平台型技术的深厚基底，持续研发攻坚与自主创新，实现氮化铝、氮化硼产品的国产化量产，打破国外垄断，随着 AI 算力设施、先进封装等超高功耗、高热流密度场景的迅速发展，高端导热散热材料作为保障芯

片性能和 AI 算力设施稳定运行的重要材料，被批量应用于 AI 服务器散热模组，存储芯片、手机芯片等半导体封装领域，迎来高速发展周期。

此外，公司致力于成为功能性材料科技创新引领者，在部分由外资主导或下世代前沿领域持续攻关并不断突破。例如电子电路基板领域，以高速覆铜板为代表的高性能覆铜板，作为印制电路板（PCB）的核心基材，已成为 AI 等算力设施的“性能基石”，基于在 M6 至 M8 等级高速覆铜板的优势基础，公司进一步开发更低损耗、空心结构、特殊异形硅微粉等前沿产品，适配 M9、M10 等级等下世代高速覆铜板及类载板（SLP）；公司战略性将产品矩阵扩展至 AI 用高密度互联 PCB、下世代玻璃基板（TGV）用电子浆料范畴，进一步夯实电子信息领域行业引领地位并不断拓展优势产品边界。在 IC 先进制造领域，公司自主开发的纳米氧化物是构成芯片抛光液的关键原材料之一，已成功应用于先进芯片制程抛光液产品；在可应用于 2.5D/3D、HBM 等先进封装的液态塑封料（LMC）、颗粒状环氧塑封料（GMC）、芯片底部填充胶（UF）功能材料领域，公司亦进行了多项技术储备。

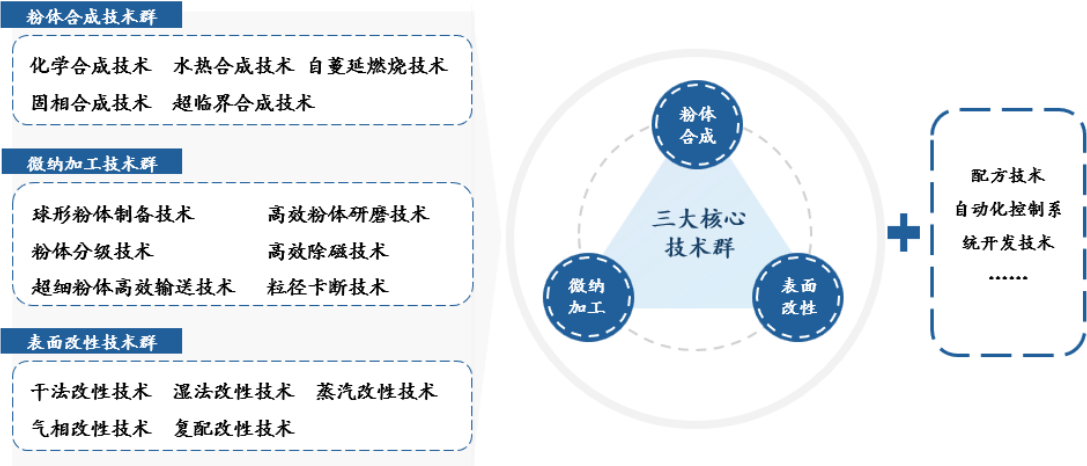
根据国家工信部组织的评比结果，公司获批为国家级专精特新（重点）小巨人企业、第四批专精特新小巨人企业。公司承担了“先进封装基板用高性能球形二氧化硅研发及产业化”国家重点小巨人“三新”“一强”推进计划项目。公司化学法球形硅微粉获中国非金属矿科学技术奖科技进步类一等奖（国科奖社字 0301 号）。根据江苏省工业和信息化厅认定工作结果，公司高性能球形硅微粉产品被认定为 2021 年度省级专精特新产品。此外，公司还获批 2025 年度全国非金属矿产品及制品领域标准化工作先进单位、中国非金属矿工业协会先进封装矿物粉体材料行业重点实验室、江苏省电子信息功能粉体工程技术中心、江苏省企业技术中心等，以主要完成单位获得江苏省材料学会科学技术一等奖、江苏省颗粒学会科技创新奖等。截至本上市保荐书出具日，公司已拥有 72 项授权专利，其中发明专利 65 项，参与制定了 2 项已发布的国家标准、1 项已发布的团体标准。

（三）核心技术

公司深耕先进无机功能性粉体材料领域，经过二十余载自主研发和创新实践，在技术原理、工序工艺、产线设备、软件系统等关键层次实现自主创新和多点突破，并在体系层面进行多点组合创新，构建以粉体合成技术群、粉体微纳加工技

术群、表面改性技术群为核心，以配方技术、自动化控制系统开发技术为补充的核心技术体系，并通过多个技术支点的综合运用，实现“原料合成-粉体加工-应用适配”的全链条覆盖。

公司核心技术体系图



公司各技术环节之间形成深度协同赋能机制。公司无机功能粉体材料主要添加于树脂等有机基材中结合使用，用于增强下游基材介电性能、尺寸稳定性、耐热性、导热性等多种核心关键性能。一方面，粉体粒径大小、粒径分布、粉体形貌（球形/角形等）等物理表征直接影响粉体性能。无机功能粉体材料高端市场曾长期被外资企业占据主导地位，绝大部分国内供应商主要参与粉体的微纳加工环节，并止步于较为成熟的微米级研磨、分级技术，较难突破更高精密度的纳米级领域，以及技术门槛较高的球形制备（尤其是化学法、直燃法球形制备技术）、粒径卡断技术。公司在粉体微纳加工技术方面优势明显，系业内少数同时掌握三种球形粉体制备技术，且较早在覆铜板领域实现规模应用的企业，并掌握精密分级、高效研磨、粒径卡断等多项核心技术，可精准控制粒径大小、粒径分布、粉体形貌及纯度等，对于改善粉体性能至关重要。

另一方面，无机粉体与有机基材的复合使用并非简单的物理混合，而是涉及界面化学等复杂作用机制，常带来有机-无机界面分离、结合力弱、相容性差等问题，直接影响整个复合材料体系的介电性能、热导率等关键指标。表面改性技术能有效解决上述应用化难题，依托改性剂作为接桥，改性剂一端的官能团与有机基材结合，另一端与无机粉体表面羟基形成共价键，有效增强界面的结合力，改善有机基材对无机粉体的浸润性和相容性。而无机粉体表面改性技术需针对复

杂有机基材体系，进行改性配方、改性工艺等多维度综合性调整适配，具有较高的技术门槛。公司掌握 30 余种改性剂反应机理，并拥有干法改性、湿法改性、蒸汽改性、气相改性及复配改性等多项改性技术，具有领先的表面改性技术优势。

伴随下游 AI 人工智能、高速网络通信、云计算等先进产业的高速发展，带动更高信号传输速率、低传输损耗、高散热效率、热稳定性等关键性能需求，驱动无机功能粉体材料性能要求持续跃升，仅通过微纳加工以及表面改性处理已逐步趋于产品性能提升的极限，亟需迈向原料开发端开展基础材料研究，结合粉体合成技术改善原材料性能进而突破产品整体性能瓶颈。例如，更高球形度、特殊空心结构、异形形貌粉体需要在粉体原料端通过化学合成技术实现，无法仅通过后段的微纳加工或表面改性处理予以突破，因而要求企业在粉体合成领域具备深厚的技术沉淀。公司是行业中少数掌握化学合成、水热合成、固相合成、自蔓延燃烧、超临界合成等多项粉体合成技术的无机功能性粉体供应商，亦是业内少数同时掌握粉体合成、微纳加工、表面改性三大核心技术群的供应商。

此外，配方技术、自动化控制系统开发技术作为重要技术补充，贯穿于粉体合成、粉体微纳加工与表面改性全链条核心环节，通过与三大核心技术群的深度融合，共同构筑起坚实的核心技术壁垒。公司核心技术具体情况如下：

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
1	粉体合成技术	化学合成技术	公司在原酸性水解-碱性缩聚分步合成工艺的基础上，自主研发形成了碱性水解缩聚一步合成技术，一步合成的有机硅球粒度均一度高、球形度高、合成反应时间短、结晶性好，同时由于没有酸催化剂产生的元素残留，因此成品杂质含量低，有利于后续加工及进一步降低煅烧后的介质损耗，最终制备的微米级至纳米级球形粉体能够达到单分散、粒度更均匀；根据中国非金属矿工业协会开具的证明，公司化学合成新工艺“避开了国外的技术封锁，极大地提升了我国高端球形硅微粉的加工水平，产品性能指标达到国际领先水平，填补了国内空白”。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 12 项发明专利予以保护
2	粉体合成技术	水热合成技术	公司通过自主改良设计的水热高温混合连续反应装置，直接合成多元复杂体系的陶瓷粉体，解决水热合成过程中易出现中间产物，造成产物中含有杂质等问题；应用特殊有机溶剂作为反应介质，进行水热-溶剂热反应，在较低的碱性溶液条件下得到高结晶性陶瓷粉体，并对其晶型结构进行精修，自主形成水热高温混合法合成亚微米粉体的技术；公司水热合成的粉体粒度均匀、粒径分布更窄、杂质含量低、结晶性更好。	自主研发	小批量生产	其他新兴功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 11 项发明专利予以保护
3	粉体合成技术	自蔓延燃烧技术	公司自主研发掌握自蔓延合成配方，并自主设计自动化自蔓延反应设备及相关产线，通过实时监控温度曲线、反应时间、设备真空度及氧含量等关键参数，搭配持续优化的配方，有效解决燃烧不充分、反应产物纯度低、氧含量高等问题；公司应用自蔓延燃烧技术合成的高纯陶瓷粉体，晶相良好（可达 100%），纯度可达 99.5%以上。	自主研发	大批量生产	导热散热功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 1 项发明专利予以保护
4	粉体合成技术	固相合成技术	公司自主研发掌握单元固相烧结和多元固相烧结的制备技术以及高温熔融配方技术，通过对烧结温度曲线的精准调控及配方粉体多相均匀分散，可制备得到晶型完整、粒度均匀的粉体材料；同时结合客户对粉	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、其他新兴功能材料等	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 14 项发明专

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
			体材料高/低介电、软硬度等方面的性能要求,开展配方自主设计,可制备多种高介电陶瓷粉体、负膨胀系数陶瓷粉体等新兴产品。				利予以保护
5	粉体合成技术	超临界合成技术	公司通过对超临界反应体系关键参数(温度、压力、pH 值及反应物浓度)的精确调控,结合下游客户对粉体材料的特定性能需求(如纳米级粒径、高结晶度、特定晶型及纯度等),自主研发设计合成配方与工艺路径,可制备技术难度较高的芯片抛光液用高端纳米陶瓷粉体。	自主研发	小批量生产	其他新兴功能材料(芯片抛光液纳米氧化物)	主要以非专利技术秘密形式予以保护
6	粉体微纳加工技术	火焰球硅球铝制备技术	公司在行业成熟的火焰熔融球化工序基础上改进球化工艺控制,通过自主研发形成的火焰熔融原料的干粉超分散、球形粉体级配、表面改性等技术,同时优化火焰熔融产线、自主设计火焰法制备球形粉体的燃烧装置,形成了具有一定性能优势的体系化火焰球硅、球铝制备技术,应用该技术制备得到的粉体纯度高、球化率高、收率高、比表面积可控、流动性好。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护,同时通过 1 项发明专利予以保护
7	粉体微纳加工技术	直燃球硅制备技术	公司较早突破基于 VMC 原理的直燃法球硅制备技术,系国内较早批量供应直燃法球硅的厂商,并实现对日资供应份额的国产替代; 公司通过自主设计的燃烧器和冷凝器特殊装置,有效解决球化过程中空心球较多的问题;通过自主研发的除大球和除羟基技术,有效减少空心球、大球含量及粉体表面羟基含量;针对性自主开发纳米物理隔离改性技术,有效解决亚微米级粉体易团聚难题,最终制备得到的产品具有纯度高、球化率高、大球及空心球含量低、流动性好、易分散等性能优势。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护,同时通过 3 项发明专利予以保护
8	粉体微纳加工技术	化学法球硅制备技术	公司较早掌握纳米级高纯化学法球硅制备工艺技术,运用自主研发的梯度煅烧技术,创新性将有机球硅转变为满足覆铜板领域低介电、低损耗要求的无机粉体,可有效避免有机硅球笼状结构内部有机基团排除	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护,同时通过 12 项,发明

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
			不充分、碳化或表面缺陷的问题，保证粉体比表面积无变化，球化率最高达 100%；通过自主研发形成的高压解聚技术，有效解决煅烧后的纳米级粉体易粘连、易团聚等问题； 应用化学法球硅制备技术生产的球形硅微粉，具有纯度高（可达 99.99%）、球化率高（可达 100%）、粒度分布窄和分散度高等性能优势，满足高等级高速覆铜板、高阶 HDI 基板、IC 载板、类载板（SLP）、芯片底部填充胶、ABF 膜等高端电子领域应用需求。				专利予以保护
9	粉体微纳加工技术	高效粉体研磨技术	依托于自主设计调整、自主搭建或改良的高效无磁球磨系统、高温空气内循环流化床气流磨系统、分级研磨一体高温蒸汽系统、盘式气流磨产线系统，公司掌握球磨、气流磨、蒸汽磨等多种高效研磨技术，可针对不同性质、形态、粒度、硬度的材料进行研磨处理，实现粉体材料的高效研磨； 相较于业内一般的微米级研磨技术，公司具备更高精密度的纳米级研磨技术能力。	自主研发	大批量生产	全系列产品	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 3 项发明专利予以保护
10	粉体微纳加工技术	高效除磁技术	结合物料在产线中流动的特性，在进料、回料、出料等多个关键节点处，自主设计添加不同除磁原理的除磁部件，实现全产线流程中对磁性杂质的精细控制；使用高磁通强力纳米除磁技术，有效去除粉体中的弱磁性物质以及被粉体包裹的磁性物质，进一步降低粉体磁性杂质； 公司产品磁性杂质水平能够达到<1ppm 级别，优于行业内平均的 10ppm 水平；在有特殊低磁性要求的场景下，除磁后粉体中的金属杂质比例接近 0，达到行业先进水平。	自主研发	大批量生产	全系列产品	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 1 项发明专利予以保护
11	粉体微纳加工技术	气流分级技术	公司凭借多年工艺经验积累，对研磨气流分级设备进行多种改造优化，自主开发设计二次风管道、主动气密封，自主搭建分级系统，可将特定尺寸的粉体颗粒	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料等	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
			进行有效分级，且分级粒度更小、更均匀，实现对大颗粒的精准管控，提升分级的效率及稳定性。				过 1 项发明专利予以保护
12	粉体微纳加工技术	蒸汽分级技术	公司创新性引入并重新设计高温蒸汽研磨分级系统，掌握蒸汽分级解聚技术，可实现各类超细粉体的分级，分级能力可达 $D50 < 0.4\mu\text{m}$ 、 $D100 < 1.4\mu\text{m}$ ，达到行业先进水平；独立重新设计喷射装置，能够根据不同比重物料的流体学计算结果调整参数，适配不同的粉体，提升分级能力和效率；自主设计蒸汽管路加温装置和收料装置，通过高温高压条件下蒸汽分级技术，减少水分降低超细粉体团聚，实现小粒径粉体的分离。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材料等	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 1 项发明专利予以保护
13	粉体微纳加工技术	超细粉体高效输送技术	公司针对不同粉体流动性存在差异的特点设计了不同的物料和管道输送装置，如自主改良进出口、卸料阀、出料篦板结构、辅助下料结构的料仓和物料输送装置，自主设计超细粉体管道输送装置等，可有效保证进出料的流畅稳定和整体生产系统的流畅运行。	自主研发	大批量生产	全系列产品	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 2 项发明专利予以保护
14	粉体微纳加工技术	粒径卡断技术	公司自主研发并搭建气相分级、液相分级、精密过滤等多种工艺技术及设备系统，利用离心力、重力、物理筛分原理，对大颗粒进行有效管控，实现粉体粒径从微米级卡断 ($5-75\mu\text{m cut}$)、亚微米级卡断 ($0.8-1\mu\text{m cut}$)，到纳米级卡断的精准控制，可满足下游客户对粉体大颗粒管控的需求。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料等	主要以非专利技术秘密形式予以保护
15	表面改性技术	干法改性技术	公司自主研发形成了成套干法改性技术，如自主设计加压喷雾装置，能够实现良好的改性剂雾化效果；自主设计多段控温技术和相关加热系统，能够根据不同改性剂水解缩合的反应特性，进行自主控温，提高改性效率，改善包覆率；自主设计排气系统，能够实现改性中及改性后无副产物残留，解决改性产品的后团聚问题； 经过干法改性处理后粉体羟基含量显著降低，对于粉	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材料等	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 12 项发明专利予以保护

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
			体流变性有较大改善。				
16	表面改性技术	湿法改性技术	公司自主研发掌握应用于球硅浆料的湿法改性工艺及改性配方,通过应用湿法改性技术,可大幅提升改性粉体或浆料在应用时的流变性能,使球硅浆料满足IC载板的要求,且流变性可达 10^4 (mPa s) 级别。	自主研发	小批量生产	电子信息功能材料	主要以非专利技术秘密形式予以保护
17	表面改性技术	蒸汽改性技术	公司在高温蒸汽研磨分级系统基础上,自主创新设计适配的改性剂雾化装置,可实现高温高压气体沸腾状态下的表面改性,改性包覆率和反应性进一步提高,改善了亚微米粉体的改性效果,实现改性粉体0团聚。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材料等	主要以非专利技术秘密形式予以保护
18	表面改性技术	气相改性技术	公司自主研发形成成套气相改性技术,采用气固相表面反应工艺,自主设计可编程气氛与温控的反应装置,通过对反应物浓度、反应温度与停留时间的精密协同调控,在高温气相环境下实现单分子层级的超薄均匀包覆,且反应充分彻底,进而显著提升纳米粉体的高纯度、高活性与高分散性。	自主研发	小批量生产	电子信息功能材料	主要以非专利技术秘密形式予以保护
19	表面改性技术	复配改性技术	公司自主研发形成多重改性配方,以及冷热复配、多次改性、无机-有机结合等改性技术,形成了完整的复配改性体系,能够满足下游客户对于粉体表面性质的多功能要求。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材料等	以非专利技术秘密形式予以保护,同时通过1项发明专利予以保护
20	配方技术	原料配方技术	公司构建了原料选型与独特配方技术,掌握不同原料组分间的相互作用、配比关系及对产品性能的影响规律,熟练运用粉体、浆料配方体系与生产工艺路径的协同适配技术,能够根据客户多样化性能要求设计出最优配方,实现介电性、导热性、热稳定性、流动性、填充率、纯度等性能突破,生产出满足电子、导热、锂电、涂料、封装等不同领域客户差异性需求的产品。	自主研发	大批量生产	全系列产品	主要以非专利技术秘密形式予以保护
21	配方技术	级配分散技术	基于“界面自由能匹配-粒径级配-表面化学协同”三元耦合技术,公司通过Furnas模型计算与实验验证相结合的方式,精准确定多元颗粒的最优配比,将	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材料	主要以非专利技术秘密形式予以保护

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
			粉体的无序堆积转化为有序密排结构,并建立较为完善的数据库;同时通过“纳米尺度润滑层”,将颗粒间摩擦转化为颗粒与树脂的界面滑移,可实现多维度协同效应,显著提升粉体填充量与导热系数。公司通过应用级配分散技术,使产品实现高填充、高导热、低粘度、高稳定等优异性能。			料等	
22	自动化控制系统开发技术		公司自主开发了产线自动化控制系统,能够根据系统化工工艺经验对整体产线进行多个维度的参数设置;自主搭建了数据采集记录系统,能够有效监测生产过程中的各节点状态,及时追溯生产过程中出现的问题。	自主研发	大批量生产	全系列产品	主要以非专利技术秘密形式予以保护

（四）研发水平

1、公司所获奖项及有关认定

截至本上市保荐书出具日，公司所获主要荣誉资质情况如下：

序号	荣誉资质名称	主体	认定部门	获得时间
1	国家级专精特新重点“小巨人”企业	发行人	工业和信息化部	2024年9月
2	国家级专精特新“小巨人”企业	发行人	工业和信息化部	2022年8月
3	非金属矿科学技术奖-科技进步奖一等奖（国科奖社字0301号）	发行人	中国非金属矿工业协会	2021年10月
4	先进封装矿物粉体材料行业重点实验室	发行人	中国非金属矿工业协会	2025年8月
5	2025年度全国非金属矿产品及制品领域标准化工作先进单位	发行人	全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会	2025年12月
6	国家高新技术企业	发行人	江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省税务局	2025年11月
7	江苏省企业技术中心	发行人	江苏省工信厅	2022年8月
8	江苏省电子信息用功能性粉体工程技术研究中心	发行人	江苏省科技厅	2022年9月
9	江苏省专精特新产品	发行人	江苏省工信厅	2021年12月
10	江苏省科技型中小企业	发行人	江苏省科技厅	2019年6月
11	江苏省高新技术企业培育企业	发行人	江苏省科技厅、江苏省财政厅	2019年9月
12	江苏省潜在独角兽企业	发行人	江苏省生产力促进中心	2025年9月
13	江苏省瞪羚计划企业	发行人	江苏省生产力促进中心	2023年11月
14	江苏省科技型民营企业	发行人	江苏省民营科技协会	2019年10月
15	江苏省科技型中小企业	南京宇热	江苏省科学技术委员会	2013年7月
16	江苏省材料学会科学技术奖 ^{注1}	发行人	江苏省材料学会	2024年12月
17	江苏省颗粒学会科技创新奖 ^{注2}	发行人	江苏省颗粒学会	2024年11月
18	苏州市独角兽培育企业	发行人	苏州市人民政府	2021年4月
19	苏州市瞪羚计划企业	发行人	苏州市人民政府	2020年12月
20	苏州市超细改性粉体工程技术研究中心	发行人	苏州市科技局	2022年8月

注1：由发行人作为完成单位、副总经理胡林政作为第一完成人参与的“低介电中空二氧化硅微球制备技术”项目，于2024年12月获得江苏省材料学会科学技术奖；

注2：由发行人作为完成单位之一、副总经理胡林政作为完成人之一参与的“掺杂改性钛酸钡纳米粉体的可控制备与应用研究”项目，于2024年11月获得江苏省颗粒学会科技创新奖。

2、公司承担的重大科研项目

截至本上市保荐书出具日，公司已完成或正在参与、承担的各级部门技术、

业务相关的项目如下：

序号	项目名称	计划类别	项目来源	项目开始时间
1	先进封装基板用高性能球形二氧化硅研发及产业化	国家重点小巨人“三新”“一强”推进计划项目	工业和信息化部	2024 年 10 月
2	电子陶瓷粉体的制备技术开发	江苏省产学研合作项目、江苏省科技副总项目	江苏省科学技术厅	2020 年 8 月
3	电路板印刷用低温固化铜浆的研发与产业化	常熟市“昆承英才”科技创新创业领军人才计划项目	常熟市科技局	2021 年 7 月

3、参与标准制定

截至本上市保荐书出具日，公司参与的标准制定情况如下：

序号	标准名称	标准编号	标准类别	发布时间	参与程度
1	集成电路封装用低放射性球形氧化硅微粉	GB/T 46381-2025	国家标准	2025 年 10 月	参与
2	集成电路封装用球形氧化铝微粉	GB/T 46378-2025	国家标准	2025 年 10 月	参与
3	锂电池隔膜涂覆用勃姆石	T/EJCCCSE 082—2024	团体标准	2025 年 1 月	参与

（五）主要经营和财务数据及指标

根据容诚会计师出具的“容诚审字[2026]215Z0053 号”《审计报告》，发行人最近三年的资产状况和经营业绩如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/ 2025 年度	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度
资产总额	191,365.14	142,257.67	107,492.15
归属于母公司所有者权益	104,775.07	88,334.82	79,073.88
资产负债率（母公司）	33.77%	32.62%	31.44%
资产负债率（合并）	45.29%	37.91%	26.44%
营业收入	103,586.02	72,857.24	51,950.91
净利润	16,517.17	8,936.38	6,604.20
归属于母公司所有者的净利润	16,602.20	8,946.61	6,609.78
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	16,354.92	8,748.54	6,479.43
基本每股收益（元/股）	0.99	0.54	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.98	0.53	0.39
加权平均净资产收益率	17.19%	10.69%	8.75%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	16.94%	10.45%	8.58%

项目	2025-12-31/ 2025 年度	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	19,876.02	6,135.37	-329.74
现金分红	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	4.07%	4.69%	5.38%

（六）发行人存在的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）技术风险

①产品迭代与技术创新风险

公司自设立以来坚持高端化发展路线，伴随全球加速进入 AI 时代，公司以高性能球形硅微粉为代表的高端产品，被广泛应用于 AI 算力设施等高阶应用领域。随着 AI 等下游先进产业向更高性能、更高集成化方向快速发展，对公司技术创新能力和迭代升级速度均提出更高要求。若公司不能紧跟下游技术和市场的发展趋势，准确把握下游行业关键技术应用的发展动态、新技术及新产品的研发方向、客户对高性能材料的需求变化，及时调整研发方向、优化产品结构并进行有效的技术储备与迭代，可能导致公司产品技术升级缓慢、竞争力下降，进而对公司经营情况及业务发展产生不利影响。

②核心技术泄密及技术人才流失的风险

公司所处的先进无机非金属材料行业，尤其是高端功能性粉体材料领域，具有技术密集型的特点。行业内公司的持续发展依赖于长期自主研发过程中构建的核心技术与知识产权体系，同时，拥有一支稳定、优秀的技术人才团队是支撑公司持续技术创新与竞争力的重要基础之一。未来，如若公司核心技术保密措施不能得到有效执行，或因行业不正当竞争导致核心技术泄密，或因激励政策不能持续吸引技术人才，造成研发人员流失，将对公司的研发创新能力和业务稳定发展造成不利影响。

（2）经营风险

①单一客户收入及毛利占比超过 50%的风险

报告期内，公司对第一大客户台光电子的销售收入分别为 20,537.03 万元、

35,980.55 万元和 56,489.64 万元，占各期营业收入的比例分别为 39.53%、49.39% 和 54.53%；公司来自台光电子的毛利贡献占比分别为 48.54%、64.39%和 75.12%。公司对台光电子的销售收入及毛利额占比超 50%，且报告期内呈现上升趋势，主要系 AI 等下游先进产业爆发式发展，催生出对高等级高速覆铜板的显著应用需求，台光电子作为高速覆铜板龙头企业，相应步入高速发展周期，并带动对公司高性能球硅的显著采购需求，公司对第一大客户销售收入及毛利占比较高，与台光电子行业领先地位、高端化发展定位，以及对发行人采购需求以高端产品为主等特点相匹配。若公司后续不能通过持续的产品升级迭代、技术创新等方式及时满足台光电子的业务需求，或者台光电子经营情况发生重大不利变化、采购需求下降或调整采购策略，则可能对公司未来经营业绩产生不利影响。

②营业收入增速放缓的风险

报告期内，公司营业收入分别为 51,950.91 万元、72,857.24 万元和 103,586.02 万元，2024 年度及 2025 年度，公司营业收入增幅分别为 40.24%、42.18%，呈现快速增长趋势，主要系公司系电子信息领域无机功能性粉体材料行业领先企业，在全球 AI 发展浪潮的驱动之下，依托高性能球硅等高端产品，紧握 AI 产业变革机遇实现快速发展。当前 AI 产业正处于基础设施集中投资建设期，倘若未来 AI 相关产业技术、发展规划发生不利变化，AI 算力设施资本投入增速放缓、出现收缩或 AI 规模化应用落地不及预期，进而影响到整体市场及公司下游客户的采购需求，则公司将面临营业收入增速放缓的风险。

（3）财务风险

①应收账款回收的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 20,151.97 万元、29,951.11 万元和 41,260.27 万元，占当期营业收入的比例分别为 38.79%、41.11%和 39.83%。未来随着公司经营规模持续扩大，预计公司应收账款余额可能进一步增加。若下游客户财务状况出现恶化，可能存在应收账款无法收回的风险，进而对公司未来经营业绩产生不利影响。

②商誉减值的风险

公司 2019 年收购山东锦艺 100%股权，支付的对价超过可辨认净资产公允价

值，形成合并商誉 1,071.12 万元。报告期各期末，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对商誉及相关的资产组进行了减值测试，公司商誉不存在减值的迹象。如果未来宏观经济环境、市场条件、下游客户需求或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，相关资产组无法实现预期的经营业绩，则公司可能面临商誉减值的风险，进而对公司的业绩表现带来不利影响。

③毛利率波动风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 30.55%、30.87%和 34.04%。公司产品毛利率主要受产品售价、产品结构、原材料价格、规模效应、公司技术水平及商务谈判等多种因素影响，若上述因素发生变化，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

④税收优惠政策变化风险

公司目前享受了高新技术企业、小型微利企业、西部大开发战略有关企业等多项所得税税收优惠。报告期内，公司享受的上述所得税优惠金额分别为 1,167.08 万元、1,076.95 万元和 1,854.16 万元，占利润总额的比例分别为 16.24%、10.72%和 9.80%。如果上述税收优惠政策发生重大变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。

（4）内控风险

随着公司主营业务的快速发展，产品结构得到持续的丰富和优化，尤其是本次股票发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规模等都将进一步扩大。与此同时，公司的生产经营管理的难度也将同步增加，对公司的技术研发、市场拓展、产品质量管控、内部控制、财务管理等方面都有了更高标准的要求。如果公司内部管理水平不能与公司业务的迅速扩张较好匹配，组织模式和管理体系不能及时跟随公司规模扩大而及时调整，公司将面临规模迅速扩张导致的经营管理和内控风险，最终对公司的盈利能力与业务发展造成不利影响。

（5）股东特殊权利恢复的风险

公司历史上融资引入外部投资人股东时，约定了股份回购权等特殊权利条款。2026 年 2 月 6 日，发行人与股份公司第一次股权转让后的各方股东签订了《关

于苏州锦艺新材料科技股份有限公司之股东协议》，以取代此前关于各方股东权利义务分配所达成的任何协议、投资意向书、谅解备忘录、陈述或其他义务中的相关内容，约定了回购权等特殊权利条款自公司提交首次公开发行股票并上市的申报材料的前一日起终止，但附有恢复生效条款。

公司若未能成功上市，部分股东可能会要求回购义务人回购其持有的公司股份，届时公司可能面临股权结构发生变化的风险。

2、与行业相关的风险

(1) 行业周期性波动的风险

公司产品主要应用于高等级高速覆铜板，高阶 HDI 板、IC 载板、类载板(SLP) 用各类高端覆铜板，以及高导热胶等导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料、半导体制造与封装材料等多个领域，终端应用领域包括 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块、低轨卫星、高端消费电子、汽车电子、半导体制造与封装等。该等行业受到宏观经济及电子信息等行业周期的影响，若未来宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓，或电子信息等行业需求出现周期性波动、技术迭代延长，传导至公司所属的上游材料行业，将可能会对公司的经营状况造成不利影响。

(2) 市场竞争加剧的风险

随着 AI 人工智能、高速网络通信、云计算等下游应用领域的快速发展与技术迭代，高性能先进无机功能性粉体材料市场需求迎来爆发式增长。在市场需求不断扩张的背景下，同行业竞争对手可能通过融资扩产、技术升级等方式加大对电子信息用高性能粉体材料的业务布局，同时未来可能有更多新进入企业，市场竞争将有所加剧。若公司未来不能及时把握市场发展机遇、精准判断行业技术发展趋势，或未能持续提升产品性能、实现下世代新产品的迭代突破，或未能在品质管控、客户服务等方面进一步巩固并增强自身优势，将对公司市场份额及盈利水平产生不利影响。

(3) 国际贸易摩擦和关税政策风险

报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 13.66%、13.97% 和 11.53%，占比较低，且出口主要面向中国台湾地区，暂未受到国际贸易形势

变化的重大不利影响。但在全球贸易保护主义抬头的大背景下，国际贸易摩擦和关税贸易保护手段可能扰动全球供应链，欧美等国家仍可能对中国新材料、电子信息、半导体产业部分战略性产品采取加征关税等贸易壁垒措施，可能导致下游行业市场需求减弱或增长不及预期，对公司经营业绩造成不利影响。

3、其他风险

(1) 与募集资金相关的风险

①募集资金投资项目的实施风险

公司本次募集资金投资项目拟投入 22.19 亿元，用于电子信息用高性能粉体材料扩产项目、扩建年产 430 吨高导热球形氮化铝粉项目、智能化升级改造项目、研发中心建设项目和补充流动资金。公司已经对上述募投项目开展全面的必要性、可行性分析，并制定《募集资金管理制度》，配备专业团队，以保障募集资金投资项目顺利实施。但未来如宏观经济环境发生变化、产品技术升级迭代滞后、竞争加剧等市场环境变动、人才储备不足、下游客户需求发生变化等，可能导致募投项目无法实现预期目标，进而对公司未来业务发展、盈利能力等产生不利影响。

②募投项目用地尚未取得的风险

公司“电子信息用高性能粉体材料扩产项目”部分项目拟自购土地进行建设，“研发中心建设项目”拟自购房产。截至本上市保荐书出具日，发行人尚未取得“电子信息用高性能粉体材料扩产项目”部分用地的土地使用权，发行人与常熟经济技术开发区管理委员会签署《电子信息高性能粉体材料项目投资协议》，约定该项目用地事宜，当地管委会承诺将协调相关载体、地块优先供应给发行人使用，并出具《说明函》：“本单位支持锦艺新材‘电子级高性能粉体材料生产基地项目’用地需求，协调锦艺新材取得相关建设用地，并根据锦艺新材项目建设计划及实际需要依法办理土地出让各项手续，保障项目按计划正常实施”；公司尚未取得“研发中心建设项目”所需房产，发行人已与常熟市信虞科技产业园有限公司签署《购买意向协议书》，明确双方交易意向，并与常熟经济技术开发区管理委员会签署《苏州锦艺研发中心项目投资协议》，当地管委会承诺将协调相关载体优先供应给发行人使用，综合上述情况，预计发行人取得募投用地不存在实质性障碍。

但上述募投项目用地的取得仍存在一定不确定性，若未来募投项目用地的取得时间晚于预期，或由于募投项目用地所在地区国土规划政策调整等原因导致募投项目用地无法落实，则公司本次募投项目可能面临延期或者变更实施地点的风险，从而对募投项目的实施造成不利影响。

③新增固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅提高，资产结构也将发生较大变化，项目建成后折旧、摊销金额较大。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定时间，在项目建成初期，新增固定资产折旧费用可能会对公司未来经营业绩将产生较大影响。如果未来市场需求出现改变，则公司可能面临因新增固定资产折旧增加导致利润下滑的风险。

④即期回报被摊薄的风险

公司完成本次发行并收到募集资金后，公司的股本总数及净资产规模将会随之大幅增长。发行人募投项目的开展、实施和产出需要一定的时间周期。募投项目的相应收益在项目全部完成实施并投产后才能逐步实现，故公司在短期内存在净资产收益率被摊薄的风险。

（2）发行失败的风险

公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败风险。

二、本次发行的基本情况

1、证券种类：人民币普通股（A股）

2、每股面值：人民币 1.00 元

3、发行股数：本次发行股票数量不超过 55,715,025 股，占发行后比例不低于 25.00%，本次发行不存在股东公开发售的情形。

4、发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式。

5、发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并有资格进行创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止的认购者除外）。

6、承销方式：由承销商采用余额包销方式或监管机构认可的其他方式。

三、保荐机构项目组人员情况

（一）保荐代表人

姚思女士：国信证券投资银行事业部高级业务总监，保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员，硕士研究生学历。2016 年开始从事投资银行工作，曾就职于海通证券，曾主持或参与南方电网子公司 IPO 项目、粤电力（000539.SZ）火电资产收购财务顾问项目、德迈仕（301007.SZ）控制权转让财务顾问项目、九州一轨（688485.SH）收购晶禧半导体财务顾问项目，以及广物控股、广州交投、广州金控等大型国有企业信用债券以及雅居乐、佳兆业等地产集团类 REITs、CMBS 项目。

宋亮先生：国信证券投资银行事业部高级业务总监，保荐代表人，硕士研究生学历。2017 年开始从事投资银行工作，曾主持或参与四方精创（300468.SZ）向特定对象发行股票项目，新疆众合（600888.SH）向不特定对象发行可转换公司债券项目，贝特瑞（920185.BJ）精选层公开发行项目，德迈仕（301007.SZ）控制权转让财务顾问等项目。

（二）项目协办人

陈翔先生：国信证券投资银行事业部高级经理，保荐代表人，硕士研究生学历。2022 年加入国信证券从事投资银行工作，曾参与德迈仕（301007.SZ）控制权转让财务顾问项目。

（三）项目组其他成员

余洋先生：国信证券投资银行事业部董事总经理，保荐代表人，管理学硕士。2008 年开始从事投资银行工作，曾主持或参与精艺股份、奥马电器、四方精创、晨曦航空、奥士康、工业富联等首发上市项目；吉电股份、辽通化工、川投能源、国际医学、亿阳信通、奥士康、四方精创等非公开发行项目；中国宝安发行公司

债券项目；中国宝安、西安民生等发行股份购买资产财务顾问项目；贝特瑞在全国股转系统挂牌、定增及精选层公开发行等项目。

潘佳琦女士：国信证券投资银行事业部业务总监，硕士研究生学历。曾在天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所从事审计工作，负责或参与金溢科技、华源控股、梦网科技、华测检测等多家上市公司年度审计工作。2022 年加入国信证券从事投资银行工作，曾参与特变电工可转债项目等。

齐刚先生：国信证券投资银行事业部业务总监，注册会计师，硕士研究生学历。2020 年加入国信证券开始从事投资银行工作，曾参与天助畅运创业板首发项目。

李锦女士：国信证券投资银行事业部高级经理，注册会计师，硕士研究生学历。2023 年加入国信证券从事投资银行工作，曾参与德迈仕（301007.SZ）控制权转让财务顾问项目。

（四）联系方式

联系地址：深圳市福田区福华路 125 号国信金融大厦 35 层

联系电话：0755-82130833

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

经核查，国信证券作为保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

五、保荐机构承诺

本保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及贵所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，并履行了相应的内部审核程序。同意向贵所保荐锦艺新材申请首次公开发行股票并在创业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持，并承诺自愿接受贵所的自律监管。

六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序

本次发行经锦艺新材第二届董事会第六次会议和 2025 年年度股东会审议通过，符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序。

七、保荐机构对发行人是否符合创业板上市条件的说明

本保荐机构对发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查，具体情况如下：

（一）符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件

1、本次发行符合《证券法》第十二条规定的发行条件

本保荐机构对本次证券发行是否符合《证券法》规定的发行条件进行了尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构；

（2）发行人具有持续经营能力；

（3）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；

（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；

（5）发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

发行人符合《证券法》第十二条的规定。

2、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件

(1) 符合《注册管理办法》第十条的规定

经本保荐机构查证确认，发行人系从有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更成立股份有限公司，其前身有限责任公司成立于 2017 年 2 月 9 日，持续经营时间从有限责任公司成立之日起计算，已在三年以上。

发行人依法设立且持续经营三年以上，不存在根据法律、法规以及发行人章程需要终止的情形，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

(2) 符合《注册管理办法》第十一条的规定

经本保荐机构查证确认，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量；最近三年财务会计报告由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

经本保荐机构查证确认，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性；注册会计师已出具了无保留结论的内部控制审计报告。

发行人符合《注册管理办法》第十一条的规定。

(3) 符合《注册管理办法》第十二条的规定

经本保荐机构查证确认，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

经本保荐机构查证确认，发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更。

经本保荐机构查证确认，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的

重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《注册管理办法》第十二条的规定。

（4）符合《注册管理办法》第十三条的规定

经本保荐机构查证确认，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

董事、监事（取消监事会前）和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条的规定。

综上，发行人符合《证券法》《注册管理办法》规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

本次发行前发行人总股本为 16,714.5075 万股，本次拟公开发行不超过 5,571.5025 万股，发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

（三）符合公开发行股份的比例要求

本次发行前发行人总股本为 16,714.5075 万股，本次拟公开发行不超过 5,571.5025 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

（四）市值及财务指标符合规定的标准

发行人本次发行上市申请适用《上市规则》2.1.2 条第（一）项规定的上市标准：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不

低于 6,000 万元。

根据容诚会计师出具的《审计报告》（容诚审字[2026]215Z0053 号），发行人 2024 年度和 2025 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别为 8,748.54 万元和 16,354.92 万元，符合所选择的上市标准。

八、保荐机构针对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明

（一）发行人能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展的核查情况

保荐机构执行了以下核查程序：访谈了发行人管理层，了解发行人产品及技术的创新性，分析公司主营业务产品与技术的创新、创造、创意特点；查阅了下游相关行业研究分析报告、公开资料，结合对发行人管理层及主要客户的访谈，了解产品在下游新兴产业的融合及应用情况；查阅了发行人研发项目明细表，核查了发行人在研项目的进展和发展方向，了解发行人技术创新与前沿技术储备情况；走访发行人主要客户，访谈了解发行人主要客户对发行人主要销售产品的性能、品质和发行人研发、技术水平的评价；查阅了行业协会出具的证明文件，确认发行人产品技术水平及发行人所处的行业地位。

经核查，保荐机构认为：发行人拥有的技术具有先进性和创新性，能够通过创新、创造、创意促进人工智能、云计算、新能源等新质生产力发展，推动行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。

（二）发行人技术创新性的核查情况

保荐机构执行了以下核查程序：访谈了发行人研发总监，了解发行人的核心技术体系、技术来源、技术先进性、技术所处阶段、技术应用情况、发明专利与核心技术的对应关系，比较分析发行人主要产品关键性能指标与同行业公司同类产品的差异，了解发行人技术或产品的先进性；查阅了发行人所处行业的研究报告、行业杂志等公开资料，查阅同行业可比公司定期报告等公开信息，了解行业技术水平和发展趋势、同行业可比公司技术情况等，分析发行人核心技术在行业内的发展水平；获取了发行人专利清单，查阅了发行人及子公司拥有的《专利证书》、国家知识产权局查册文件等资料；通过国家知识产权局网站网络核查等方式，了解发行人知识产权权利状况；查阅了发行人研发项目明细表，核查了发行

人在研项目的进展和发展方向，了解发行人技术创新与前沿技术储备情况；查阅了发行人获得的重要荣誉奖项及所拥有的资质证书；获取并查阅发行人承担重大科研项目的相关资料，了解发行人研发活动和技术水平；查阅了发行人参与制定的标准文件及参与标准制定的证明文件，核查发行人参与标准制定情况。

经核查，保荐机构认为：发行人拥有和应用的技术具有一定的先进性，发行人具备较强的创新能力。

（三）发行人属于现代产业体系的核查情况

保荐机构执行了以下核查程序：查阅了公开行业研究报告、国家产业政策、行业发展规划、行业法律法规及规范性文件，查阅同行业可比上市公司公开资料，了解发行人所处行业情况；查阅了《战略性新兴产业分类（2018）》和《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，了解发行人所属行业是否为国家重点支持和发展的战略性新兴产业，分析发行人是否属于现代产业体系。

经核查，保荐机构认为：发行人构建了覆盖粉体合成、微纳加工、表面改性等核心工艺环节的核心技术体系，具备进一步研发、深度利用相关技术及模式的能力，且该能力具备可持续性；涉及现代产业体系领域的产品属于发行人核心产品，发行人具备较强的创新能力。

（四）发行人成长性的核查情况

保荐机构执行了以下核查程序：查阅了行业主管部门制定的产业政策、发展规划，发行人所处行业的研究报告、公开资讯等资料，了解相关行业发展趋势、市场空间等；访谈了发行人管理层，了解发行人核心技术情况、所属细分行业的竞争情况及行业地位、未来业务的持续性和成长性等；查阅了发行人的审计报告，了解发行人业绩变动情况，并对其营业收入、净利润的成长性进行分析；查阅了发行人的销售明细表，结合对主要客户的访谈程序，分析发行人收入变动的原因，是否与行业情况相匹配；检索了发行人所处行业资讯、主要客户公开资料，了解AI等产业发展趋势、下游客户景气度等，结合对发行人管理层、主要客户的访谈程序，分析发行人未来收入增长的可持续性。

经核查，保荐机构认为：发行人所处市场空间的表述准确；报告期内，发行人收入、利润呈现持续增长态势，符合成长性特征，发行人成长性来源于其核心

技术和产品；发行人具备较强的研发创新能力支撑其成长性，发行人未来业绩增长具备可持续性。

（五）发行人符合创业板行业领域的核查情况

保荐机构执行了以下核查程序：查阅了《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）等文件，通过公开资料检索等方式，核查并明确发行人所属行业领域，并分析发行人主营业务与所属行业归类的匹配性；查阅了《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》及《产业结构调整指导目录》等文件，了解发行人所处行业是否属于“负面清单”所列行业；查阅了同行业可比上市公司公开资料，分析可比公司行业分类与发行人是否存在重大差异；实地察看了公司生产经营场所，了解公司主营业务情况，分析其是否依赖国家限制产业开展业务。

经核查，保荐机构认为：发行人所属行业领域为国家战略新兴产业、鼓励类产业，不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市的行业或禁止类行业，符合创业板规定的行业范围；发行人主营业务与其所属行业归类匹配，与可比公司行业领域归类不存在显著差异；发行人依托自主研发的核心技术开展生产经营业务，不存在主要依赖国家限制产业开展业务的情形。

（六）发行人符合创业板定位相关指标的核查情况

保荐机构执行了以下核查程序：查阅了发行人的审计报告，了解发行人业绩和研发费用的变动情况，复核发行人创业板定位相关指标的计算过程；了解与收入确认相关的关键内部控制制度，并测试相关内部控制的运行有效性，查阅了发行人的收入明细表，结合对销售收入的细节测试，检查与收入确认相关的支持性文件，并通过销售回款测试、收入截止性测试等程序核查发行人销售的真实性、准确性；对主要客户执行函证、访谈等核查程序；获取了发行人报告期内研发费用明细表，分析研发费用构成及变动情况，并对研发费用进行抽样测试，核查研发费用核算是否准确。

经核查，保荐机构认为：发行人营业收入、研发费用真实、准确，发行人主要产品属于现代产业体系领域，发行人符合创业板定位相关指标要求，属于成长

型创新创业企业。

九、对发行人持续督导期间的工作安排

事项	安排
（一）持续督导事项	国信证券将根据与发行人签订的保荐协议，在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，认识到占用发行人资源的严重后果，完善各项管理制度和发行人决策机制。
2、督导发行人有效执行并完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	建立对高管人员的监管机制、督促高管人员与发行人签订承诺函、完善高管人员的激励与约束体系。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	尽量减少关联交易，关联交易达到一定数额需经独立董事发表意见并经董事会（或股东会）批准。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件	建立发行人重大信息及时沟通渠道、督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露要求和规定。
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况跟踪和督促。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐人进行事前沟通。
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责；严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注，并进行相关业务的持续培训。
（四）其他安排	无

十、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦35层

邮编：518000

电话：0755-82130833

传真：0755-82131766

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

在充分尽职调查、审慎核查的基础上，保荐机构认为，发行人首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、行政法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在创业板上市的条件。

鉴于上述内容，本保荐机构推荐发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市，请予批准！

（以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于苏州锦艺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人: 陈翔
陈翔

保荐代表人: 姚思 宋亮 2016年6月23日
姚思 宋亮

内核负责人: 曾信 2016年6月23日
曾信

保荐业务负责人: 鲁伟 2016年6月23日
鲁伟

法定代表人: 张纳沙 2016年6月23日
张纳沙

